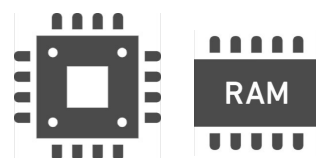


フィジカルAIと半導体 —業界縦断の連携環境整備—

昨年度に国内半導体とデータセンター（DC）に残る問題を調査し、半導体は国内に牽引役となる需要家が不在であり、応用システムのリード役が必要なこと、またDC業は顧客が要望する仕様に従うしかなく、国内DC業は主要顧客がGAFAM等である現状では、DC側の意向を入れる余地が殆どない点などを示した。

今後はどちらの業界も対顧客従属に留まらず、顧客と相補的・一体的に市場拡大を進める方策が必要で、国内発の強い応用システム、たとえばフィジカルAI産業等の繁栄が必須である。そのフィジカルAIはわが国機械産業にとって発展機会であると同時に脅威でもある。機会を堅固につかむには、AI応用の機械企業と、デバイス等のサプライサイド企業の、互恵的連結の環境整備が必要かつ有効である（含人材グローバル化推進等）。



(一財) 機械振興協会経済研究所 名誉フェロー

井上 弘基 氏

4月24日(金) 13:30~15:00

- WEBシステムによる開催 (Zoom) 事前申込制 (先着100名 参加費無料)
- お申込み方法

URL: <https://forms.gle/eU8FhmabMqjT1JU87>

または下記コードよりお申し込みフォームへアクセスし、**4月21日(火)**までにお申し込みください。



受講票は発行いたしません。

受講時にご使用していただく資料およびWEB会議参加証は前日までにメールにてお送り致します。

なお、ご提供頂く個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用致しません。

WEB会議中の画面録画や録画した映像の転載は禁止させて頂きます。

お問い合わせ先 機械振興協会 経済研究所 企画管理室 E-mail: info@eri.jspmi.or.jp